



辛耘 (3583)

2022年12月28日

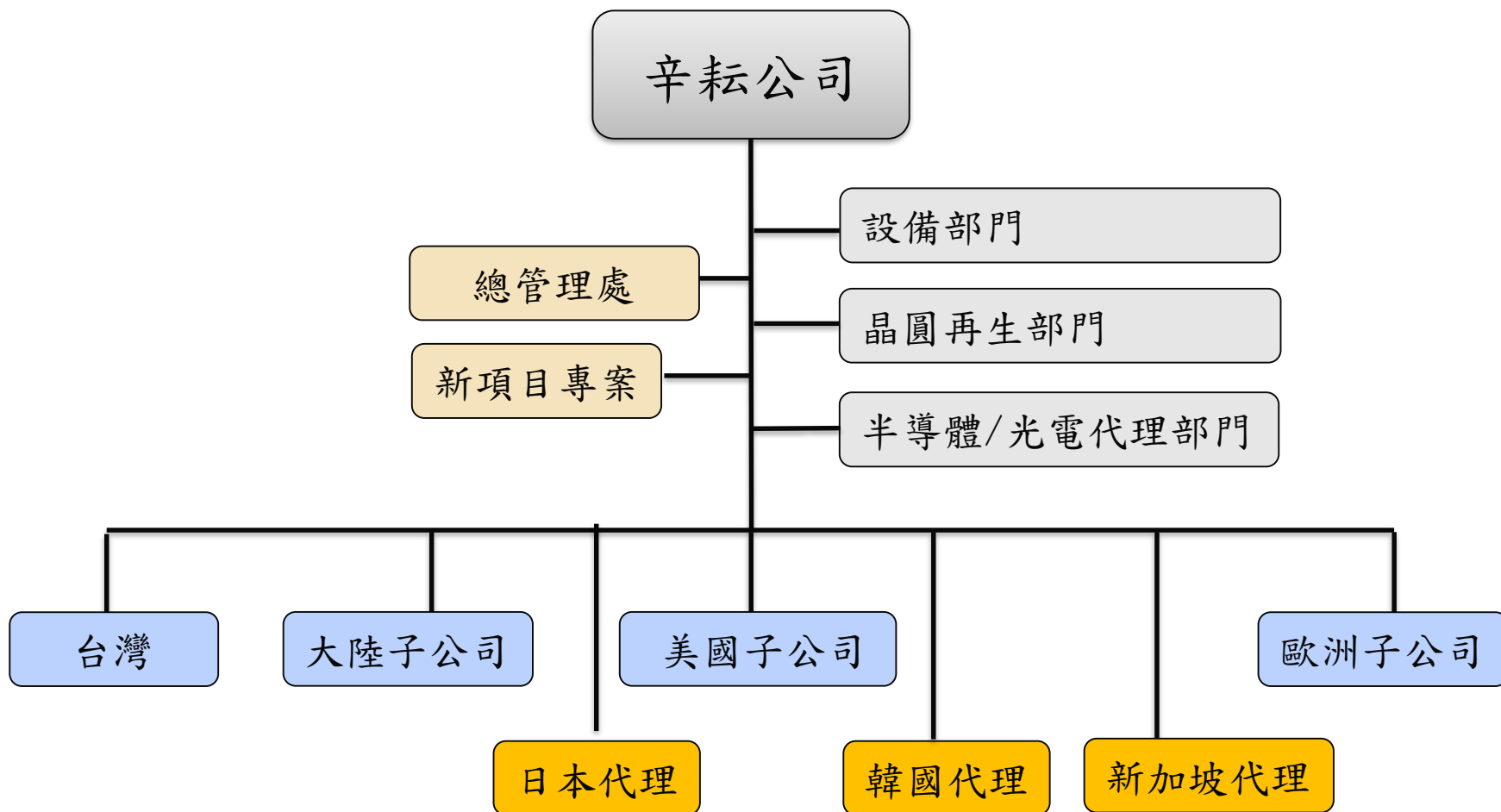
免責聲明

- 本簡報可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時又受限於已知或未知的風險與不確定性的影響。因此實際結果將可能不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

基本資料

成立時間	1979/10/17
董事長	謝宏亮
執行長	許明棋
資本額	8.11億元
營收(2021)	46.84億元(集團合併)
員工人數	740人(集團合併)
據點	台北、湖口、新竹、台南、高雄、大陸(上海等17個城市)、香港、美國、歐洲(奧地利)、日本、新加坡、韓國
主要業務	自製設備、晶圓再生、設備代理

辛耘公司組織架構



營運概況

主要產品

公司治理

未來展望

單位：百萬	2017	2018	2019	2020	2021	2022/Q3
營業收入	<u>3,539</u>	<u>3,988</u>	<u>3,949</u>	<u>3,580</u>	<u>4,684</u>	<u>4,077</u>
營業毛利	<u>1,251</u>	<u>1,448</u>	<u>1,384</u>	<u>1,456</u>	<u>1,667</u>	<u>1,508</u>
營業費用	829	935	997	991	1,112	1,024
營業淨利	423	514	387	465	555	485
營業外收入及支出	(8)	26	16	(76)	(31)	56
稅前淨利	415	540	403	389	524	541
本期淨利	328	418	323	305	420	425
EPS(元)	<u>4.05</u>	<u>5.16</u>	<u>4.02</u>	<u>3.80</u>	<u>5.23</u>	<u>5.29</u>
毛利率	35%	36%	35%	41%	36%	37%
營業淨利率	12%	13%	10%	13%	12%	12%
稅前淨利率	12%	14%	10%	11%	11%	13%

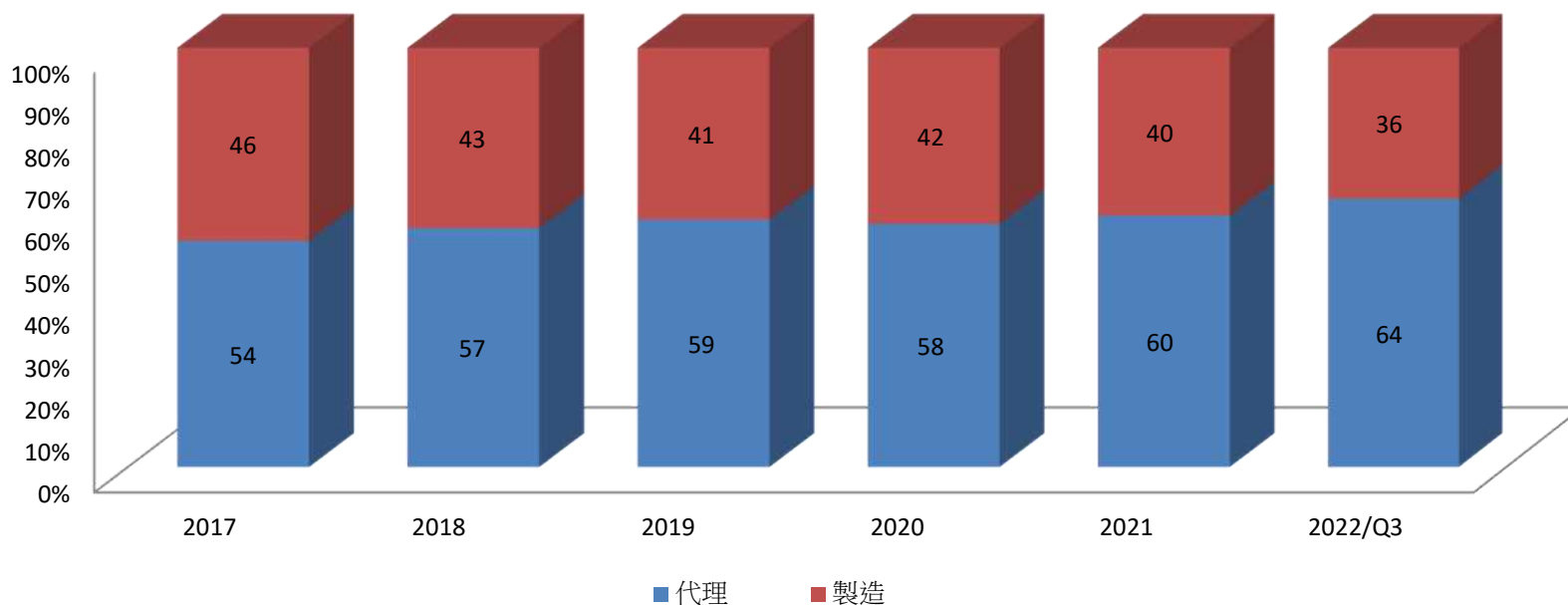
營運概況

2022/Q3 營運概況



單位：百萬	1Q21	2Q21	3Q21	1Q22	2Q22	3Q22	3Q21累計	3Q22累計	成長率
營業收入	956	1,002	1,290	1,254	1,383	1,440	3,248	4,077	26%
營業毛利	266	397	480	461	511	536	1,143	1,508	32%
營業費用	253	219	288	332	338	354	760	1,024	35%
營業淨利	13	178	192	129	173	183	383	485	27%
營業外收入及支出	24	(8)	(22)	26	3	28	(6)	57	-1045%
稅前淨利	37	170	170	155	176	211	377	542	44%
本期淨利	20	147	130	121	152	152	297	425	43%
EPS(元)	0.25	1.84	1.61	1.51	1.89	1.89	3.70	5.29	43%
毛利率	27.8%	39.6%	37.2%	36.8%	36.9%	37.2%	35.2%	37.0%	+1.8ppt
營業淨利率	1.4%	17.8%	14.9%	10.3%	12.5%	12.7%	11.8%	11.9%	+0.1ppt
稅前淨利率	3.9%	17.0%	13.2%	12.4%	12.7%	14.6%	11.6%	13.3%	+1.7ppt

單位：%	2017	2018	2019	2020	2021	2022/Q3	毛利率
代理	54	57	59	58	60	64	低於平均
製造	46	43	41	42	40	36	高於平均

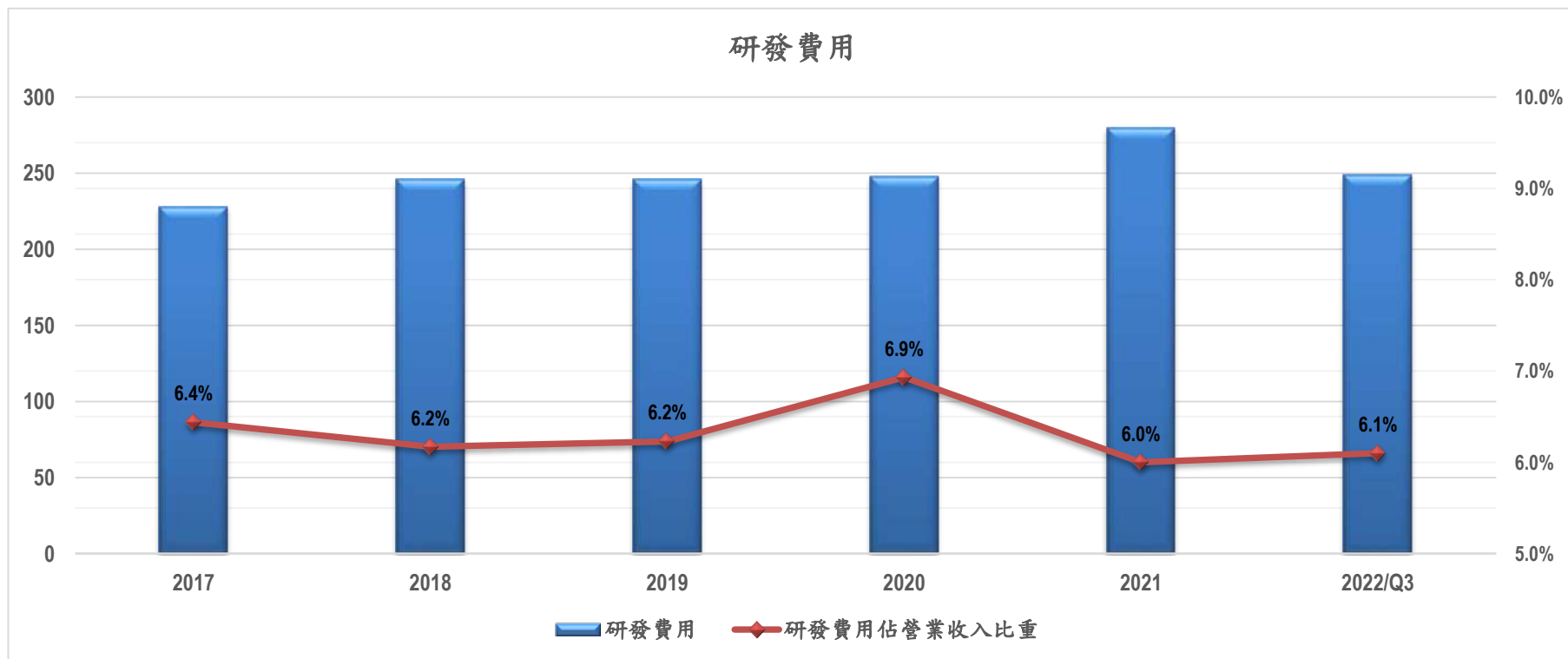


營運概況

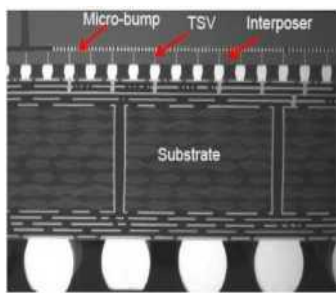
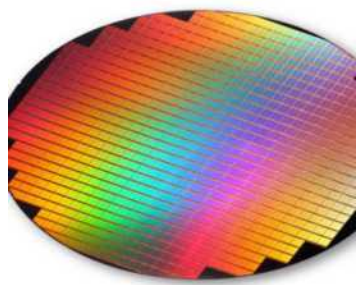
研發費用



單位：百萬	2017	2018	2019	2020	2021	2022/3Q
研發費用	228	246	246	248	280	249
研發費用 佔營業收入比重	6.4%	6.2%	6.2%	6.9%	6.0%	6.1%



- 我們服務的產業：
 - 半導體 (前段/先進封裝)
 - 化合物半導體
 - LED / Mini LED / Micro LED
 - 平面顯示器 (TFT-LCD, AMOLED, Touch Panel)
 - 太陽能/電池
 - 生物科技/分析儀器



- 半導體
- 化合物半導體
- LED
- 平面顯示器
- 太陽能/電池
- 生物科技/分析儀器

設備生產

- 濕式製程設備
- 暫時性貼合及剝離設備
- 半導體/化合物/LED

代理事業

晶圓再生

- 12" Si (矽) Wafer
- 6" SiC (碳化矽)

● 辛耘公司



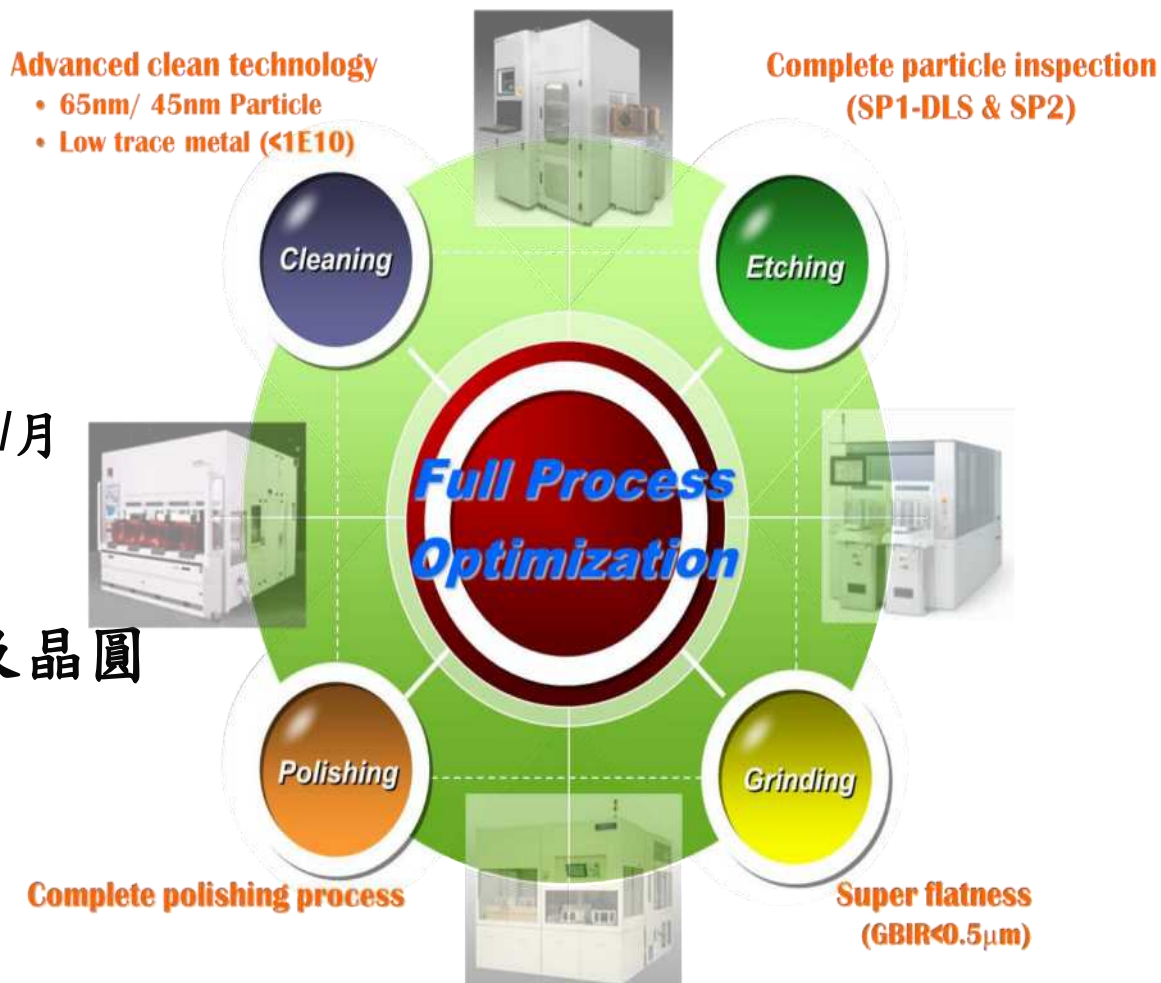
SCIENTECH

■ 12"Si晶圓再生

- ◆ 產能: 12 → 14 → 16萬/月
- ◆ 銅及非銅製程分離

■ SiC長晶後全製程及晶圓再生

- ◆ 產能: 800 / 月



- 辛耘公司



SCIENTECH

- 批次式及單晶圓濕式製程設備
- 應用：
 - ◆ 半導體先進封裝製程
 - ◆ 半導體前段製程
 - ◆ 化合物半導體製程
 - ◆ 微機電製程
 - ◆ LED/Mini-LED/Micro-LED製程



- 辛耘公司



SCIENTECH

- 暫時性貼合及剝離設備(TBDB)
- 應用: IGBT功率器件, 半導體先進封裝
 - ◆ 暫時性貼合設備
 - ◆ 暫時性剝離設備
 - ◆ 解離層塗佈設備
 - ◆ 承載盤清洗設備



主要產品

設備代理



公司治理

ISO



Initial Certification

2014/5/27

Valid Date :

2020/5/28 ~ 2023/5/27



Issue 4. Certified since

2010/3/24

Valid Date :

2019/4/30 ~ 2022/4/30



Issue 3. Certified since

2019/4/30

Valid Date :

2019/4/30 ~ 2022/4/30



Issue 1. Certified since

2019/11/20

Valid Date :

2019/11/20 ~ 2022/11/19



Issue 1. Certified since

2021/09/29

Valid Date :

2021/09/29 ~ 2024/09/28



ISO14001

ISO45001

ISO27001
資訊安全

ISO22301
營運持續

ISO9001


Taiwan Intellectual Property Management System

台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 驗證登錄證書
Certificate of Taiwan Intellectual Property Management System

貴公司所建置之智慧財產管理制度，通過台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 推行體系之驗證，特此證明。相關登錄事項如下：

一、公司名稱：辛耘企業股份有限公司
二、受評部門：全公司
三、受評地址：新竹縣新豐鄉中華路18號
四、證書編號：TIPS-2016-驗證-008
五、有效期限：2021/12/31
六、管理標的：■專利 ■商標 □著作權 ■營業秘密 □積體電路佈局
排除適用：無
七、驗證類別：■AA級 □A級 (2016年版)

經濟部工業局
局長 呂正華

Certificate of Compliance
This is to certify that the Intellectual Property Management System of the following organization has been verified and fulfilled the requirements of TIPS.

1. Company Name : Sciencetech Corporation
2. Registered Department : All Company
3. Registered Address : No. 18, Jhonghua Rd., Hukou Township, Hsinchu County 30352, Taiwan (R.O.C.)
4. Number of Registration : TIPS-2016-cert-008
5. Date of Expiration : December 31, 2021
6. Items : ■ Patent ■ Trademark □ Copyright ■ Trade Secret
□ Integrated Circuit Layout
Exclusion : None
7. Certification Level : ■ AA □ A (2016)

Director General
Intellectual Development Bureau, MOEA
Richard Lee

簡報結束
謝謝！

Q&A